

【景美科技 2026 年 3 月營收新聞稿】

景美科技 (7899) 3 月營收 創歷史新高 年季月三增齊揚 日系測試機機框出貨 推升成長

2026 年 4 月 9 日 / 新北市

先進製程測試介面結構件供應商 景美科技 (7899) 今 (9) 日公告，2026 年 3 月合併營收達新台幣 70,822 仟元，較去年同期(YoY)成長 56%，較上月(MoM)成長 56%，呈現年增、季增與月增同步走揚的成長態勢，並刷新公司成立以來歷來營收最高紀錄。累計 2026 年第一季合併營收約新台幣 179,429 仟元，較上季(QoQ)大幅成長約 75%，展現公司在 AI 與先進製程測試需求升溫帶動下的強勁營運動能。

3 月營收創高 年季月全面成長 第二季動能延續可期

3 月營收創下歷史新高，主要受惠於 AI 高效能運算 (HPC)、先進製程與高階測試需求同步升溫，帶動探針卡關鍵結構件及微細鑽孔出貨顯著成長。3 月營收較去年同期成長 56%、較上月成長 56%，呈現短期客戶拉貨動能明顯轉強；第一季累計營收較上季成長約 75%，顯示公司中長期營運趨勢持續向上。

景美科技發言人 鄭雅文表示，本季營收同步呈現年增、季增及月增全面成長，不僅反映短期客戶需求升溫，更代表公司中長期成長動能與產業布局逐步成形。尤其在高訊號接點密度、高頻高速訊號測試趨勢下，探針卡導板與結構件單位加工價值提升，進一步強化整體營運表現。展望第二季，隨既有客戶訂單及新專案進入量產階段，整體營運動能可望延續第一季成長態勢，穩健向上。

通過晶圓代工廠驗證 日系測試機機框 為成長動能之一

景美科技業務協理 張鎂擘 表示，第一季營收其中一項核心動能，來自於 4Q25 順利通過晶圓代工廠驗證，正式切入日系測試機機框 (Stiffener) 供應，並自 1Q26 開始穩定出貨，快速成為市場主力供應商。目前 AI GPU 與 ASIC 晶片測試，市場仍以日系 93K 為主力測試平台，隨著 AI 晶片測試需求擴大，相關機框訂單需求同步成長。依目前接單能見度觀察，日系測試機機框 全年訂單數量可望不低於目前既有美系測試機機框，成為推升第一季營收成長的來源之一。

在產業長線成長趨勢明確下，景美科技對全年營運表現深具信心，將以技術領先、品質穩定與量產效率優勢，穩步推升營收與獲利成長，創造具競爭力的長期價值。

全球信賴的半導體測試介面核心專家
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

景美科技自結營收簡表 (公開資訊觀測站公告營收)： 單位：新台幣仟元；%

年度/月份	2026 年	2025 年	增減百分比
3 月	70,822	45,399	YoY +56% MoM +56%
1~3 月	179,429	104,757	YoY +71% QoQ + 75%

新聞發言人：品牌總經理鄭雅文 winwin_cheng@cmat-tek.com.tw 0933-888-334

公司簡介：

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商 景美科技股份有限公司 (7899.TW) 於 2026 年 2 月 25 日正式登錄興櫃交易。公司成立於 2006 年，專注於半導體先進製程探針卡細微鑽孔與結構件之設計、製造與銷售，實收資本額約新台幣 2.29 億元。景美科技深耕探針卡結構件近 20 年，客戶涵蓋全球最大晶圓代工廠、歐美日韓探針卡廠及台灣前三大探針卡廠，產品包含晶圓測試(CP)用垂直式探針卡 (VPC) 與微機電探針卡 (MEMS) 之關鍵結構件，核心產品涵蓋上下導板細微鑽孔 (Upper Plate / Lower Plate)、ATE Stiffener、Spacer、JIG、Backer 等高精度、高門檻關鍵結構件，為高階晶片測試不可或缺的重要組成。

景美科技之競爭優勢包括：1.具備完整之探針卡結構件設計與開發能力。2.兼具高強度合金金屬材料、高性能工程塑膠與複合材料之整合實力。3.以高精度組裝工藝有效控制公差累積，確保模組功能性與高度可靠性。4.具備少量多樣高客製化的彈性製造能力。5.以夥伴思維深度融入客戶供應鏈，建立互補協作模式並加速產品認證。